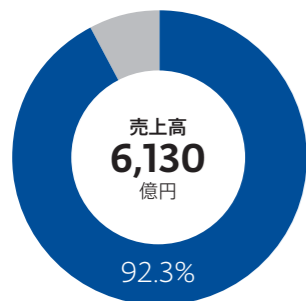


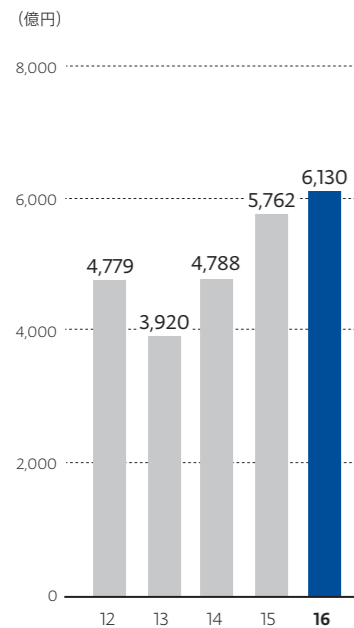
## 部門別営業概況および事業展望

## 半導体製造装置

## ■ 売上高構成比



## ■ 売上高



## ■ 事業環境

2015年は、スマートフォンやデータセンター向けサーバーの高機能化が進み、一台当たりのメモリ搭載容量が増加したことに加え、サーバーの出荷台数も伸びたことから、メモリ需要は堅調に推移しました。一方、PCやスマートフォンの出荷台数が伸び悩んだため、先端ロジック半導体の需要は弱含みしました。

このような状況のもと、ファウンドリおよびロジックメーカーの設備投資は前年に比べ抑制されましたが、メモリメーカーの設備投資は伸長しました。DRAMについては微細化向けの投資が大きく伸長し、NANDフラッシュメモリについては3次元構造を採用した新メモリ向け投資が大半を占めました。この結果、2015年の世界の半導体前工程設備投資全体では、前年と同水準の約315億米ドルとなりました。

## ■ 営業概況

- ▶ 部門売上高：これまで注力してきた成膜装置と洗浄装置が伸長し、前期比6.4%増加の6,130億円
- ▶ 成長戦略の一つと位置づけている成膜装置では、最先端の微細化に対応したALD\*装置の売上高が前年比約50%の増加
- ▶ 洗浄装置は、戦略製品の顧客展開が順調に進み、売上高が前年比約30%増加
- ▶ 地域別では旺盛なメモリ投資を受け、日本、中国、台湾の売上高が伸長
- ▶ 高い技術力を有する装置メーカー認定の中古機やパーツの需要が高まり、フィールドソリューション事業の売上高が前期比で約8%増加

\* ALD (Atomic Layer Deposition) : 原子レベルで一層ずつ膜を堆積させる成膜手法

## ■ 事業展望

IoT (Internet of Things) 時代の到来を見据えると、あらゆるデータを収集するセンサーなどの簡易な半導体が大量に必要なとともに、人工知能やビッグデータの分析・情報処理に用いられる最先端の半導体需要も高まることが予想されます。これらの需要を支える半導体製造装置においても、先端技術と旧世代技術の両端における半導体用途の拡がりにより新たな事業機会が創出されることで、製造装置市場は継続的に拡大すると考えています。

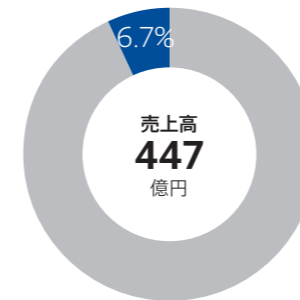
最先端の半導体向けには、当社が持つ豊富な先端技術を効果的に結合させ「Next Generation Product」をタイムリーに提供し続けていきます。回路線幅のさらなる微細化、デバイス構造の3次元化などの技術的転換点を迎えている中、市場成長が期待されるエッチング、成膜、洗浄分野に特に注力しています。エッチング装置において高い加工精度、成膜装置において高い生産性と膜質を同時に実現するなど、先端技術により差別化した装置でリーディングポジションを確立し、製品シェア向上を目指します。

一方、旧世代装置で製造する簡易な半導体向けには、業界随一の納入済み装置台数59,000台を強みに、旧世代装置の販売やアップグレードの需要に迅速に対応するとともに、顧客の生産性向上に寄与するべく、パーツやサービスを含めた包括的なソリューションを提案することで、フィールドソリューション事業の売上をさらに伸ばしていきます。

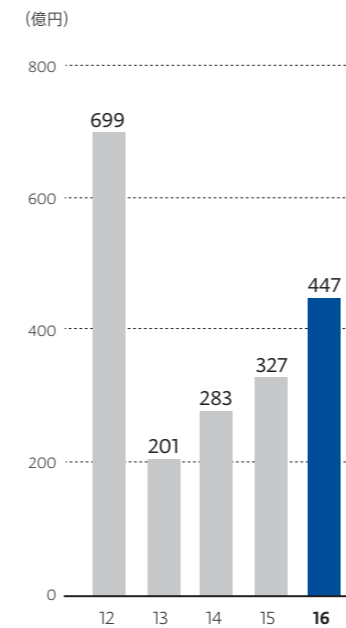
このように、当社は両世代の技術ニーズに対応することでIoT社会の構築に貢献し、同時に継続的な売上増加と利益成長につなげていきます。

## FPD 製造装置

## ■ 売上高構成比



## ■ 売上高



## ■ 事業環境

2015年のフラットパネルディスプレイ (FPD) 面積需要は、液晶テレビとモバイル端末向けがそれぞれ前年比で10%以上増加しました。このような状況のもと、薄膜トランジスタ (TFT) アレイ工程向けFPD製造装置市場は、主に中小型パネル向けの設備投資が牽引役となり、前年比で20%以上伸長しました。地域別では中国における堅調な投資に加え、日本と台湾での投資が伸長しました。

## ■ 営業概況

- ▶ 部門売上高：前期比36.6%増加の447億円
- ▶ 地域別売上高：引き続き中国向けが大半を占めるが、台湾向けが回復
- ▶ 高精細な大型パネル向けで優位性を持つエッチング装置のシェア向上
- ▶ 顧客開発ライン向けに有機ELパネル製造用インクジェット描画装置の売上を計上

## ■ 事業展望

今後は、液晶テレビおよびスマートフォンの平均画面サイズの大型化が進むことにより、FPDの面積需要は継続して拡大することが予想されています。また、将来的には有機ELテレビやデジタルサイネージの利用拡大も期待されます。

このような状況のもと、2016年のTFTアレイ工程向けFPD製造装置市場は、大型パネル向け設備投資の増加に加え、中小型パネル向け投資が大幅に伸長することで、全体では前年に続き20%の増加を見込んでいます。

大型パネル向けには、低消費電力と高精細化を実現する酸化物半導体 (IGZO) に対応した、技術的優位性を持つエッチング装置を引き続き拡販します。中国では超大型となる第10.5世代パネル生産ラインの設備投資が計画されています。第10世代向けの量産採用実績を生かして、収益性向上に結びつけていくことを目指します。

一方、中小型パネル向けには、高精細化に対応した低温ポリシリコン (LTPS) の採用が進み、加工均一性の大幅な向上と消費電力の効率化を実現する、昨年リリースした新しいエッチング装置でシェア向上を目指します。

高コントラストとフレキシブル化で注目される有機ELディスプレイについては、顧客の大型パネル用開発ラインの有機発光層成膜工程向けに、当社のインクジェット描画装置が採用されています。今後も、顧客のパネル製造技術と生産性向上に寄与することで、量産採用を目指します。